

台灣區黏性膠帶工業同業公會 函

地 址：台北市信義路五段五號 4B13 室
電 話：(○二)二七二五二二一七
傳 真：(○二)二七二二九二四四
電子信箱：tapemfgr@ms74.hinet.net

受文者：各相關業者

發文日期：中華民國 108 年 9 月 12 日

發文字號：台黏帶字第 108069 號

主 旨：訂期舉辦「2019 年產業技術研討會」，隨函檢奉預定課程表、空白報名
表及學員基本資料表各乙份，敬祈 踴躍報名參加。

說 明：一、根據本會年度工作計畫及理、監事聯席會議決議案辦理。

二、擇期十一月六日(星期三)、十一月七日(星期四)兩天，假台北市信
義路五段五號世貿展覽中心大樓二樓第四、五會議室，舉辦「2019
年產業技術研討會」。

三、本次技研會，由「台灣陶氏化學公司」、「崇越電通公司 / 台灣信越
矽利光公司」、「佑順發機械公司」、「美商伊士曼化學公司」等四個
單位協辦，另外「工研院材化所」、「中華民國工安衛協會」及「
驊創企管顧問公司」等亦派專家支援。

四、為鼓勵參與，若於九月二十七日前完成報名繳費者，公會提供九折優待
報名方式請上公會網站線上報名，公會網 <http://www.taiwantape.com/>
請詳填所需資料，完成報名；並填附學員資料表(一人一份)，和空
白報名表一併回傳至公會，傳真：(02)2722-9244，聯絡人：簡毓瑱小姐。

五、名額有限(預定兩百名)，有意參加者敬請在十月九日前填妥上述資
料，連同報名費(每人新台幣捌仟元)以掛號郵寄或親駕本會會所辦理
報名，額滿為止，逾期恕不受理。

理 事 長

宗名時